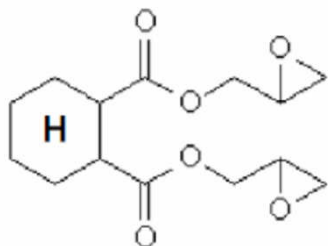


透明・低粘度・柔軟性エポキシ樹脂 EPOX MK R540

特徴/Characteristic

無水ヘキサドロフタル酸のジグリシジルエステル系の透明・低粘度・柔軟型のエポキシ樹脂です。
 This is epoxy resin with transparency・low viscosity・flexibility.

構造式/structural formula



組成・成分情報/ Composition・ingredient information

Chemical name or generic name	Concentration	Chemical formula	CAS-No
1,2-シクロヘキサジカルボン酸ジグリシジル	≤99%	C14H20O6	5493-45-8
1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, bis(oxiranylmethyl) ester; Diglycidyl hexahydrophthalat			

基本特性 / Basic characteristics

Shape	EEW g/eq	Viscosity mPa	Total-Cl %	Gardner	Flash point °C	Solvent Solubility
Liquid	155~170	350~550	1.0	1	214	○

硬化物性比較/Comparison of cured physical properties

	Test method	unit	R540	Bis-A
荷重たわみ温度	JIS K 7197-2	°C	102	148
Flexural Strength	JIS K 7171	Mpa	137	128
Flexural Modulus		Mpa	3240	2800
Tensile strength	JIS K 7162	Mpa	90	84
Tensile Modulus		Mpa	3080	2600
Tensile fracture strain		%	9	9
IZOT衝撃強度 Impact strength	JIS K 7110	KJ/m2	2.7	2.1
Surface resistivity	JIS K 6911	X 10 ¹⁶ Ω	5	5
Dielectric breakdown	JIS C 2110-1	KV/mm	24	26

硬化条件

硬化剤：ヘキサドロフタル酸無水物 硬化促進剤：PX-4MP

配合比 Epoxy/Hadner/Catalist → 100/90/1

硬化条件 100°C * 3H → 170°C * 3H → 冷却

用途例 / Application exampe

LED封止剤、接着剤、液晶関連封止用途など

LED sealant, adhesive, liquid crystal related sealing applications, etc.

上記数値は参考値であり保証するものではありません

The above values are reference values and there is nothing to guarantee